

股票代號 6525



捷敏股份有限公司 GEM Services, Inc.

法人說明會 2024/05/16





免責聲明

本次法說會所提供之簡報內容包括對於未來狀況之預測與評估之陳述,乃基於公司目前可得資料之概略說明,其涉及風險及不確定性,並可能發生實際結果與預期狀況有重大差異的情形,提醒的位不要依賴這些資訊,另除非法律要求本公司將不負責更新或公告這些預測的結果。



簡報內容

- > 公司概況
- > 營運概況
- > 財務概況
- > 未來展望
- > Q&A



公司概况

3



公司簡介

基本資料

• 公司名稱: 捷敏股份有限公司 (GEM Services, Inc.)

• 資本額:1,290M TWD

• 營業額:1,444M TWD (截至2024年4月)

產能

• 產能:大於70億顆

• 員工人數:約2,000人

提供服務

Turnkey services from wafer dicing to shipment





重要里程碑

2000~ 2012~ 2002~ 2006~ 1998~ **♦**Established a **♦**E-LaserGroup become **♦GEM Services. ◆GEM Electronics ◆GEM Electronics** strategic alliance (Hefei) Co., Ltd principal stockholder Inc. Company (Shanghai) Co., Ltd with a large **Established Established** Established Japanese trading **♦GEM Tech, Ltd.** company in the Taiwan Branch Establish Japanese market Y2013~ Y2006~ Y2008~ Y2010~ Y2002~ Y2000~ TO277 TO252/DPAK SOIC8 GEMPAK5060 GEMPAK3333 **GEMTAB** GEM2928 2018~ 2021~ 2023 **Developing** 2016~ **◆LFPAK5X6 Start ♦**Listed on the ◆Certified IATF-16949 **♦**Hefei New Building Piolt run **TWN Stock** Constructed to Exchange expand 3x space Y2015~ Y2014~ Y2016~ Y2017~ Y2023~ Y2021~ TO220FP/AB DIP23 TO263 Easypack TO247AD **TOLL** Sawn QFN TO263-6/7L LFPAK5x6 AC











- 土地面積:19,000平方公尺(租賃)
- 建築佔地面積:約 15,000平方公尺
- 樓地板面積:約18,000平方公尺

6





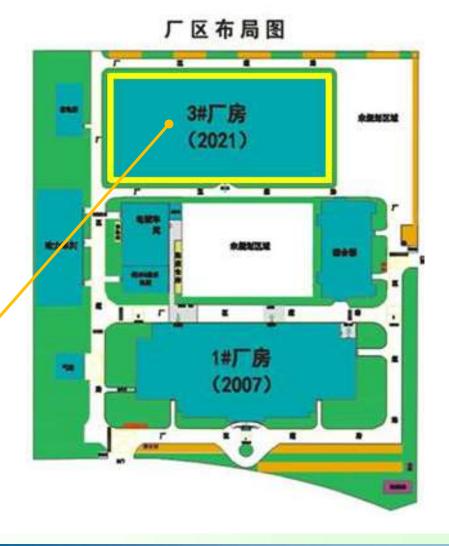


• 土地面積: 69,812平方公尺(自有)

• 建築佔地面積: 約28,000平方公尺

• 樓地板面積: 約68,000平方公尺







終端產品應用

- 提供高低壓功率金氧半場效電晶體(Power MOSFET)、 絕緣柵雙級型電晶體(IGBT)、 二極體(Diode)及電源轉換或電源管理 IC (Power Management ICs)、功率模組等之封裝 與測試服務
- 主要應用於 通訊、電腦/筆電主機板及周邊產品、家電消費性電子產品,以及任何需要電力系統供其運轉之車用電子及工業用設備機具應用等

終端應用



通訊:智慧型手機、UPS、5G基地台

Communication: Smart Phone, UPS, 5G Base station



PC:伺服器、印表機、硬碟

PC: Server, Printer. HDD



消費性電子:空調、照明、家電

Consumer: Air conditioner, Lighting, Home appliance



車用:車載充電器、逆變器、DC-DC轉換器、空壓機

Hybrid/electric vehicle: OBC, Inverter, DC-DC, Compressor



工業:機電、太陽能、風能

Industry: Electronics system, Soler, Wind Energy



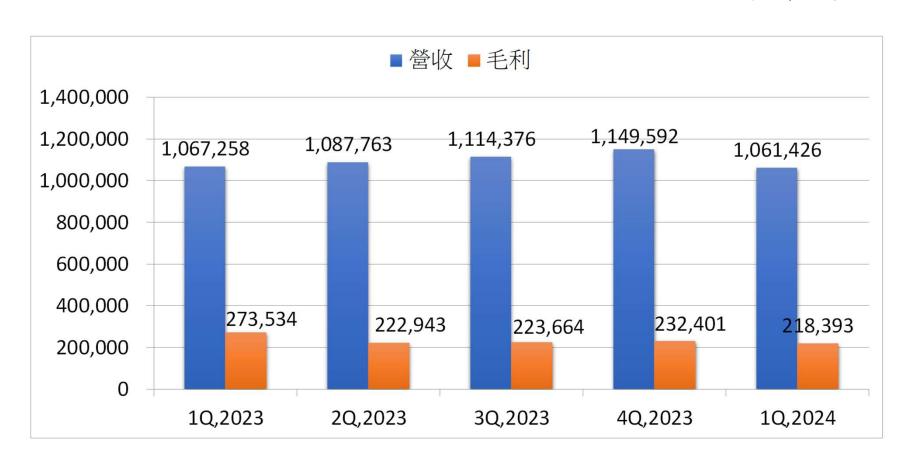
營運概況

9



合併營收與毛利

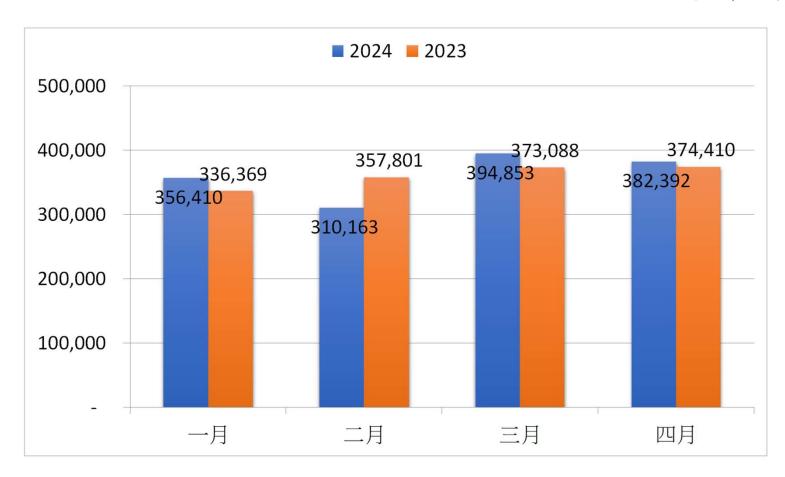
新台幣:仟元





2024年各月份合併營收

新台幣: 仟元





合併損益表

			單位:新台幣仟元		
	2024年第一季		2023年第一季		
	金額	%	金額	%	
營業收入	1,061,426	100%	1,067,258	100%	
營業毛利	218,393	20%	273,534	26%	
營業費用	88,747	8%	74,036	7%	
營業淨利	129,646	12%	199,498	19%	
營業外(損)益	66,520	7%	1,707	0%	
稅前淨利	196,166	19%	201,205	19%	
所得稅費用	39,713	4%	41,263	4%	
本期淨利	156,453	15%	159,942	15%	
EPS(元)	1.21	-	1.24	_	



合併資產負債表

					單位:新	台幣仟元
	2024/3/31		2023/12/31		2023/3/31	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	2,007,565	32%	1,731,493	28%	2,039,206	30%
應收款項	797,127	13%	790,791	13%	780,552	11%
存貨	161,208	3%	172,243	3%	202,569	3%
流動資產合計	3,213,182	51%	2,949,942	48%	3,315,214	48%
不動產廠房及設備	2,792,844	44%	2,883,166	47%	3,222,306	47%
非流動資產合計	3,098,523	49%	3,197,037	52%	3,566,950	52%
資產總計	6,311,705	100%	6,146,979	100%	6,882,164	100%
應付帳款	572,594	9%	592,455	10%	594,940	9%
其他應付款	993,046	16%	594,417	10%	1,569,383	23%
流動負債合計	1,817,097	29%	1,441,079	23%	2,507,539	36%
非流動負債合計	535,766	8%	550,631	9%	584,099	9%
權益總計	3,958,852	63%	4,155,269	68%	3,790,526	55%
負債比率	37%	-	32%	-	45%	-
流動比率	177%	-	205%	-	132%	-
每股淨值(元)	30.68	-	32.20	-	29.37	-



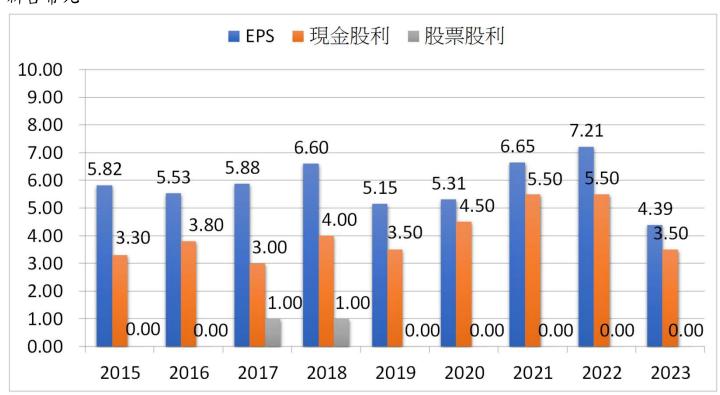
合併現金流量表

	單位:新台幣仟元		
	2024年第一季	2023年第一季	
營業活動之淨現金流入	192,691	241,711	
投資活動之淨現金流出	(5,644)	(165,141)	
籌資活動之淨現金流出	(7,873)	(1,136)	
匯率變動之影響	96,898	(9,865)	
現金及約當現金淨增加	276,072	65,569	
期初現金及約當現金餘額	1,731,493	1,973,637	
期末現金及約當現金餘額	2,007,565	2,039,206	



股利政策







未來展望

- 持續高附加價值,以及第三代半導體相關產品之開發。
 - * SiC分離器件:持續開發1200V以上高功率產品的封裝及測試。
 - * SiC 模塊:整合客戶需求擬定產品共同開發計劃。
- 5G、工業用及車用產品市場仍是發展重點。
 - * 依電源轉換總成散熱冷卻系統需要,開發高功率元件與 散熱面(Top EP cooling)整合之系列產品。



Q&A



謝謝

